



HSPT-01 **热封测试仪**采用热压封口测试原理,适用于测定软包装复合膜、塑料薄膜基材、涂布纸及其它热封复合膜的热封压力、热封温度和热封时间等参数;是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器。

一、基本信息

| | | | |
|-----------|-------|-----------|---------|
| 品名 | 热封测试仪 | 型号 | HSPT-01 |
| 品牌 | 泉科瑞达 | 产地 | 山东·济南 |

二、产品特征

国际品牌气动元件、PID 温度控制器、进口高速高精度采样芯片，保证试验条件准确

7 寸高清彩色触控液晶屏，方便试验操控，界面适时显示设定温度与实际温度、压力、时间

开机密码登陆，防止非相关人员随意开机，四级权限管理

菜单式界面，各项试验功能独立菜单式操作，参数设置与试验操作方便

专业 GMP 计算机通信软件可选，以实现数据溯源、多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能



温度：系统集成控温设计，系统控制二个 PID 控制器实现上下封头独立控温，用户只需要录入温度即可全自动控温，无需人工单独对 PID 控制器进行操作

压力：知名品牌数字压力传感器显示，压力调整与控制精度高；下置双气缸同步回路设计，出力均匀

时间：磁性（行程）开关计时，消除空行程时间，实现时间参数的精准控制

手动和脚踏两种试验模式，人机交互友好，防烫伤人性化安全设计

标配微型打印机，具有数据查询、统计、打印功能

运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器安全

三、测试原理

熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料，会表现出不同的热封性能，其封口工艺参数可能差别很大。热封试验仪采用热压封口法，将待热封试样置于上下热封头之间，在预先设定的温度、压力和时间下，完成对试样的封口，通过在不同的温度、压力和时间等试验条件下对试样热封合试验，再配合相关检测仪器可获得精确的热封性能指标。

四、产品应用领域

| | | |
|-------------|------|--|
| 基础应用 | 薄膜材料 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验，热封面为光滑平面，热封宽度可以根据用户的需求进行设计 |
| 扩展应用 | 塑料软管 | 把塑料软管管尾放在上下封头之间，对管尾进行热封，使塑料软管成为一个包装容器 |
| | 果冻杯盖 | 把果冻杯放入下封头的开孔中，下封头的开孔和果冻杯的外径配合，杯口的翻边落在孔的边缘，上封头做成圆形，下压完成对果冻杯的热封（注：需定制配件） |



五、技术指标

| 指标 | 参数 |
|------|---------------------------------|
| 热封温度 | 室温 ~ 300°C |
| 热封压力 | 0.05 MPa ~ 0.7 MPa (取决于热封面积) |
| 气缸数量 | 双气缸, 同步回路 |
| 热封时间 | 0.1 ~ 9999.9s |
| 控温精度 | ±0.2°C |
| 热封面积 | 330 mm×10 mm(可定制) |
| 加热形式 | 双加热 (上下封头, 独立控制) |
| 气源压力 | 0.7 MPa ~ 0.8 MPa (气源用户自备) |
| 气源接口 | Φ6 mm 聚氨酯管 (压缩气源用户自备) |
| 电源 | 标配: AC 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 550mm (L)×340 mm (W)×450 mm (H) |
| 净重 | 40kg |

六、参考标准

QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003

七、产品配置

标准配置: 主机、脚踏开关、微型打印机 (热敏)

选购件: 专业软件、通信电缆、加长聚氨酯管。

备注: 本机压缩气源接口系Φ6mm 聚氨酯管; 气源和气源转接头用户自备; 若加购软件则计算机由用户自备。


附：部分仪器操作界面


注：泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆 www.qktester.com 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。